

た か だ こ ら む

SEMICON[®] Japan 2021 に出展

2021年12月15日(水)～17日(金)、東京ビッグサイトにて開催された「SEMICON[®] Japan 2021」に出展し、装置技術のPRを行いました。東京オリンピック開催に伴う会場の縮小、新型コロナウイルス感染拡大によるリアル展示会中止（オンラインによるバーチャル展示会への変更）などにより、高田工業所の単独出展は2018年以降、3年ぶりとなりました。

今回、全体の来場者数は26,626人（2019年：51,109人）と、2019年開催時と比較すると半減しましたが、当社ブースには例年以上の多くのお客様が訪れ、大盛況となりました。

SEMICON Japan は今回で45回目の開催となる世界最大級のエレクトロニクス製造サプライチェーン総合展示会です。その核となる半導体製造装置・材料については前工程から後工程までの全てを網羅する大規模国際展示会です。

その中で当社は、2020年にリリースした超音波カッティング装置「CSX501」を実機初展示、切断事例として最新デバイス解析などを中心にPRし、新たな顧客獲得を目指しました。

【展示内容】

1. 実機展示とパネル展示

- ・超音波カッティング装置（CSX501、CSX-100Lab）の実機展示
- ・超音波アシスト切断の原理や効果などをアニメーション動画にて紹介
- ・ダイシング装置としてSiC、AlNなど切断対象の切断実績を紹介
- ・超音波カッティング装置による断面観察作業の効率化PRや切断事例の紹介
- ・洗浄装置のアプリケーション事例やカスタム装置の紹介

2. 切断サンプル

- ・スマートフォンなどに使用される電子部品や車載用電子部品の切断サンプルを展示

今回も多くの方に当社装置や技術に関心を持っていただき、装置メーカーとしての認知度向上を図ることができました。今後も装置メーカーとして定着できるよう技術力、販売力を強化して販売拡大を目指してまいります。

古木 勝義（装置事業部）

※SEMICON は semi の登録商標です。



洗浄も切断も多くのお客様が来場



ARを利用して装置内部を説明